

첨단생산장비연구부

연수예정부서		조정밀장비연구실	연수책임자	박아영
채용분야		박사후연구원(YS)-01	채용인원	1명
연수목표		차세대 반도체디스플레이 조정밀 스마트 패키징 공정장비 기술 개발		
연수범위 (주요수행업무)		<ul style="list-style-type: none"> - 차세대 반도체·디스플레이 패키징 공정 설계 기술 - 공정 설계 기반 조정밀 반도체·디스플레이 스마트 패키징 장비 개발 - 유연/연신 기판용 배선 설계 및 연신 특성 평가 		
참여(예정) 연구과제		자율주행차용 유연 투명 디스플레이 나노기반 생산장비 핵심기술 개발		
자격 사항	학위	박사		
	전공	기계공학, 재료공학, 디스플레이공학 등		
연수시작(예정)월		2023. 11.		
연수기간		임용일로부터 1년 (최대 3년 / 1+1+1년)		
근무지		대전(본원)		
기타사항		<ul style="list-style-type: none"> - 반도체/디스플레이에 공정·장비에 대한 전반적인 이해 및 지식 - 디스플레이/패키징 공정 및 장비 시뮬레이션에 대한 지식 		